

Kurztitel

Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung von Halbleitern, Gleichrichtern und Fotozellen

Kundmachungsorgan

BGBI. II Nr. 213/2000

Typ

V

§/Artikel/Anlage

§ 1

Inkrafttretensdatum

18.07.2001

Abkürzung

AEV Halbleiterbauelemente

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz 1959

Text

§ 1. (1) Bei der wasserrechtlichen Bewilligung einer Einleitung von Abwasser aus Betrieben oder Anlagen gemäß Abs. 2 in ein Fließgewässer oder in eine öffentliche Kanalisation sind die in **Anlage A** festgelegten Emissionsbegrenzungen vorzuschreiben.

(2) Abs. 1 gilt für Abwasser aus Betrieben oder Anlagen mit folgenden Tätigkeiten:

1. Herstellen von Halbleiterbauelementen (Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Thyristoren, Triacs, integrierte Schaltungen und Ähnliche) einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlungen;
2. Herstellen von Solar- und Fotozellen einschließlich der zugehörigen Vor-, Zwischen- und Nachbehandlungen;
3. Herstellen von keramischen Bauteilen für elektronische Anwendungen;
4. Reinigen von Abluft und wässrigen Kondensaten aus Tätigkeiten der Z 1 bis 3.

(3) Abs. 1 gilt nicht für die Einleitung von

1. Abwasser aus Kühlsystemen und Dampferzeugern (§ 4 Abs. 2 Z 4.1 AAEV);
2. Abwasser aus Laboratorien (§ 4 Abs. 2 Z 4.3 AAEV);
3. Abwasser aus der Wasseraufbereitung (§ 4 Abs. 2 Z 4.4 AAEV);
4. Abwasser aus der Herstellung von Leiterplatten (§ 4 Abs. 2 Z 6.4 AAEV);
5. Abwasser aus der Herstellung von Grundstoffen für Halbleiterbauelemente (raw wafers);
6. Häuslichem Abwasser aus Betrieben gemäß Abs. 2.

(4) Soweit diese Verordnung keine von der AAEV abweichende Regelung enthält, gilt die AAEV ausgenommen § 4 Abs. 7 AAEV für Abwasser aus der Reinigung von Abluft, die in Tätigkeiten des Abs. 2 anfällt. Fällt im Zuge eines Herstellungsvorganges gemäß Abs. 2 Abwasser aus einem galvanischen Prozess an, so ist dieses Abwasser als Teilstrom im Sinne des § 4 Abs. 7 Z 1 AAEV derart

zu behandeln, dass für einen maßgeblichen gefährlichen Abwasserinhaltsstoff der Emissionswert entsprechend der Abwasseremissionsverordnung für den Herkunftsbereich Behandlung und Beschichtung metallischer Oberflächen (§ 4 Abs. 2 Z 6.4 AAEV) vor der Vereinigung mit sonstigem (Ab)Wasser eingehalten wird.

(5) Sofern es bei einer rechtmäßig bestehenden Einleitung gemäß Abs. 1 für die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen der Anlage A erforderlich ist, oder sofern bei einer beantragten Einleitung gemäß Abs. 1 die Einhaltung der Emissionsbegrenzungen der Anlage A nicht durch andere Maßnahmen gewährleistet ist, können unter anderem folgende die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse von Betrieben oder Anlagen gemäß Abs. 2 betreffende Maßnahmen entweder bei alleinigem oder bei kombiniertem Einsatz in Betracht gezogen werden (Stand der Vermeidungs-, Rückhalte- und Reinigungstechnik):

1. Verminderung des Wasserverbrauches und Abwasseranfalles durch
 - Einsatz wassersparender Spültechniken (zB Mehrfachkaskaden, Tauchspritzspülen, Leitfähigkeitsweichen usw.),
 - Auftrennung der Spülwässer in für die Mehrfachverwendung geeignete und ungeeignete Teilströme mit Mehrfachverwendung der geeigneten Spülwässer nach Zwischenreinigung (zB durch Ionentausch, Membrantechnik und ähnlichem),
 - weitestgehende Kreislaufführung von Wasser aus der Abluftwäsche,
 - Weiterverwendung schwach belasteter Teilströme in anderen Bereichen (zB als Kühlwasser, Reinigungswasser, Waschwasser in der Abluftwäsche, in der Galvanik oder der Leiterplattenherstellung),
 - Einsatz von Speicherbecken zur Sammlung von Spritzverlusten, Reinigungswässern oder Leckagen,
 - Weiterverwenden verbrauchter Prozesslösungen (zB Säuren, organische Lösemittel);
2. vom Prozessabwasser gesonderte Erfassung und Behandlung von Retentat aus der Reinstwasseraufbereitung und Behandlung entsprechend der AEV Wasseraufbereitung (zB mittels Membranverfahren);
3. Verzicht auf den Einsatz von gasförmigen Halogenen, soweit dies auf Grund der angewandten Produktionsverfahren möglich ist;
weitestgehender Verzicht auf den Einsatz halogener organischer Lösungsmittel, sofern die Gefahr besteht, dass diese mit Wasser in Kontakt kommen können;
4. Verzicht auf den Einsatz von Arbeits- oder Hilfsstoffen mit wassergefährdenden Eigenschaften, soweit dies auf Grund der eingesetzten Produktionsverfahren möglich ist; Beachtung der ökotoxikologischen Angaben in den Sicherheitsdatenblättern der eingesetzten Stoffe; weitestgehender Verzicht auf den Einsatz von Polyaminocarbonsäuren und deren Salzen;
5. bevorzugter Einsatz physikalischer oder physikalisch-chemischer Verfahren zur Zerstörung von Komplexbildnern; bei Einsatz chemischer Verfahren bevorzugte Anwendung von Ozon, Wasserstoffperoxid oder anderer Persauerstoffverbindungen;
weitestgehender Verzicht auf den Einsatz von Chlor oder chlorabspaltenden Chemikalien;
6. gesonderte Erfassung und Reinigung arsen-, cadmium-, selen- und komplexbildnerhaltiger Abwasserteilströme;
7. Einsatz von Pufferbecken zur Abminderung von Abwassermengen- und Schmutzfrachtspitzen;
8. Einsatz physikalischer, physikalisch-chemischer oder chemischer Abwasserreinigungsverfahren für einzelne Teilströme (zB Oxidation/Reduktion, Fällung/Flockung, Extraktion, Membrantechnik, Elektrolyse) und für das Gesamtabwasser (zB Neutralisation, Sedimentation, Filtration, Fällung/Flockung, Ionentausch);
9. vom Abwasser gesonderte Erfassung und Verwertung der Rückstände aus der Produktion und Verarbeitung sowie der bei der Abwasserreinigung anfallenden Rückstände oder deren Entsorgung als Abfall (AWG, BGBl. Nr. 325/1990).

Schlagworte

Vorbehandlung, Zwischenbehandlung, Solarzelle, Vermeidungstechnik, Rückhaltetechnik, Arbeitsstoff, Abwassermengenspitzen

Zuletzt aktualisiert am

11.11.2025

Gesetzesnummer

20000780

Dokumentnummer

NOR40009146